

愛普科技股份有限公司

2025.11.04 法人說明會

林郁昕 財務長

大家午安，我是愛普科技財務長林郁昕，歡迎各位投資先進參與愛普科技法人說明會，在會議的初段，我們將進行本公司 2025 年第三季的財務狀況及業務報告，簡報過後會進入問答階段，線上參與的投資朋友請於畫面右下角欄位輸入您的問題，我們將於整理後統一回覆。

免責聲明的部分再請各位留意。

第 3 及第 4 頁是愛普科技的簡要資料，提供各位參考。

本次法說會會先由我來說明 2025 年第三季財務數字重點，洪志勳總經理將報告營運狀況以及未來展望，之後進行 Q&A，今天的與會團隊除了洪志勳總經理及我之外，還有陳文良董事長、薛澤源業務中心副總以及劉宗寧產品中心副總也會在線上回覆提問。

首先由我這邊進行財務狀況報告。

首先說明 2025 年第三季的合併損益情形，愛普第三季在 IoT RAM™各應用領域需求維持強勁及 S-SiCap™產品線出貨大幅增加之下，單季合併營收金額為新台幣 14.9 億元，較第二季及去年同期分別增加 12%及 17%，因愛普銷貨主要為美元計價，還原為美元銷貨來看，則美元營收季增 16%、年增 27%；第三季毛利金額為 6.9 億元，QoQ 及 YoY 分別增加 23% 及 4%。

第三季毛利率為 46%，QoQ 增加 4 個百分點，主要受惠於本季度匯率變動帶來的會計成本有利變化、S-SiCap™產品線的毛利率隨著量產趨穩以及 IoTRAM™產品線的銷售組合有利變化；毛利率 YoY 減少 6 個百分點，除了匯率變動影響外，主要是因為高毛利率的 VHM™產品線占比下降。稍後總經理會再做說明。

本季營業費用為 3.1 億元，較上季增加約 1,600 萬元，QoQ 增加 6%；較去年同期增加 2,400 萬元，YoY 增加 9%；本期營業費用的增加主要來自於管理費用的影響，管理費用增加主要來自於本季因退出海寧長盟合夥案而估列了財顧費用，此案的具體細節稍後會再進一步的說明。本季研發費用變動不大，季減及年減金額分別為 520 萬元及 260 萬元，主要是客戶專案 Milestone 認列以及獎金時間性差異造成的，這是會計認列上的正常波動。隨著研發人力的佈建及 VHM™、S-SiCap™各項專案的開展，預期研發費用金額長期來看仍會持續上升。營業費用率因營收增加而降低 1 個百分點為 21%，QoQ 及 YoY 變動不大。

營業利益為 3.8 億元，QoQ 金額受到營收及毛利率增加的影響，增加 41%，與去年同期相比則金額相當；本季營業利益率為 25%，QoQ 因毛利率上升而增加 5 個百分點，YoY 減少 5 個百分點，主要是毛利率下降的影響。

業外收支部分，第三季業外淨收入為 4.8 億元，主要來自於兌換利益 2.6 億元、利息收入 8,500 萬元、以及金融資產評價利益 1.2 億元的影響數。金融資產評價利益主要來自於大陸轉投資海寧長盟的估值增加，本公司在 9 月 6 日經董事會決議並公告，將以人民幣 1.45 億元（約合新臺幣 6.2 億元），退出海寧長盟合夥投資，第三季以擬退夥金額作為評價的依據，認列了 1.2 億元的評價利益，預計將於年底前結案。

兌換利益來自於第三季底美元兌新台幣匯率升值 3.9%的影響，本公司有 2.6 億美元的資金部位，其中 1.8 億元來自於 GDR 募資資金。因本公司 GDR 募資資金除了研發投入之外，尚未大幅動撥，加上既有的外幣資金、收付款等淨外幣部位，持續會受到匯率波動的影響，尚未動用的部位主要承作定期存款，美元利率區間約在 3.5 到 4.5%，每季利息收入約 8 到 9 仟萬左右，可部分抵銷匯率的波動；排除 GDR 相關兌換損益及所得稅影響數的擬制設算資料會在下一頁做說明。本公司除透過美元和新台幣的利差來提供一部分自然避險，也持續評估金融工具來降低匯率風險，並透過資金區域分散配置來因應地緣政治的風險。

第三季稅前淨利為 8.6 億元，所得稅費用 1.7 億元，稅後淨利金額為 6.9 億元，其中歸屬於本公司業主的稅後淨利為 7.1 億元，因上季為虧損，在本業獲利穩定增加、業外收入大幅挹注下，QoQ 增加 12 億元，YoY 則增加 3.6 億元，成長 110%，歸屬於本公司業主的稅後淨利率為 47%，單季每股盈餘為 4.34 元。

如果排除 GDR 未支用資金所產生的兌換損益，2025 年第三季業外淨利益為 2.7 億元，主要來自於既有外幣淨部位的兌換利益 5,700 萬元、利息收入 8,500 萬元及金融資產評價利益 1.2 億元的影響數。而將 GDR 相關匯率影響排除後，第三季淨利金額將為 5.3 億元，其中歸屬於本公司業主的稅後淨利為 5.4 億元，歸屬於本公司業主的稅後淨利率為 36%。擬制調整後每股盈餘為 3.32 元。

GDR 資金的運用，本公司一直比較謹慎。這部分資金的目的是要投入研發以及 3DIC 的生態。在 3DIC 生態形態越來越清晰，我們預計在未來兩年內完成必要的投資，並將剩餘的 GDR 資金，申請改變資金用途，用於營運資金或其他。

合併資產負債表的部分，季底總資產為 134 億元，較第二季底增加 1.8 億元。其中，現金及約當現金為 55 億元、按攤銷後成本衡量的金融資產為 38 億元，總計金額約 93 億元，合計占總資產的 70%。按攤銷後成本衡量的金融資產是本公司承作三個月以上的定期存款。與第二季底現金及按攤銷後成本衡量之金融資產這兩個科目合計數相較，淨減少數約 2 億元，主要來自於營業活動應收帳款回收、定存利息所帶來的淨現金流入、合約負債預收貨款、應付帳款支付貨款、支付現金股利及其他相對營業項目支出的現金流出互抵後的淨影響數。

第三季底應收帳款 5.8 億元，較第二季底增加 7,400 萬元，收款天期維持在 1 到 2 個月，整體應收帳款回收狀況良好。存貨金額為 10 億元，較第二季底增加 6,100 萬元，增加 6.5%，目前庫存下降到 5 個月，本公司認為 7 個月左右為庫存的合理水位，本季度庫存降低是來自於客戶拉貨的影響，將持續依據接單狀況來動態管理。

本季度按公允價值衡量的金融資產季增約 2.8 億元，包含本公司透過損益按公允價值衡量的海外投資部位海寧長盟估值提高約 1.2 億元，海寧長盟在第三季底總帳面價值為 6.2 億元，如前面所報告，海寧長盟帳面價值是用預計處分金額來評價，預計在第四季完成退夥程序；此外，本公司在本季投資海外新創公司 HamminX，金額約 1.5 億元，並帳列於透過其他綜合損益按公允價值衡量的金融資產。

第三季底的總負債為 18 億元，負債比率為 14%，較第二季底減少 5.5 億元，主要為支付現金股利 11.4 億元、動撥 2 億元短期借款、合約負債增加 1.2 億元、應付帳款增加 9,400 萬元及應付所得稅增加 1.2 億元的淨影響數。YoY 負債比率增加 6 個百分點，主要是短期借款、合約負債及應付所得稅的增加。公司把客戶的預付款列為合約負債。

股東權益總金額為 115 億元，扣除非控制權益 1.4 億元，歸屬於本公司業主的權益金額為 114 億元，較第二季底權益淨值增加 7.8 億元，每股淨值為 70.14 元。

以上是就財務資訊的相關說明，接下來時間由洪志勳總經理說明營運狀況，謝謝！

洪志勳 總經理

謝謝財務長。各位投資先進大家好，接下來由我為大家報告第三季的營運狀況。

本季營運報告將延續前季的架構，分 IoTRAM™、S-SiCap™以及 VHM™ 三個產品線，分別為各位報告業績狀況。

首先我們來看 Revenue 以及 Gross Margin。2025 年第三季合併營收達 14.9 億，較前季增加了 12%，YoY 則增加 17%，營收增長主要來自於 IoTRAM™以及 S-SiCap™。

本季 IoTRAM™營收 11 億，與前季相當，YoY 則是增加 22%；本季 IoTRAM™營收占比 74%。

VHM™產品本季營收為 7 千 7 百萬，主要為 NRE 的收入，季增 1 仟萬左右，YoY 減少 76%，主要是去年第三季 VHM™有加密貨幣的 Wafer Sales，而本季沒有，所以占比下降到了 5%。

S-SiCap™產品線本季營收為 3.14 億元，QoQ 增加 84%，YoY 則增加 614%，主要來自 S-SiCap™ Interposer，也就是我們的 IPC，多個專案進入量產的挹注。S-SiCap™產品線本季營收占比達 21%。

本季毛利率為 46%，較前季增加 4 個百分點。

本季毛利率較前季上升，主要是來自兩個因素，其中由於台幣匯率變動，對成本的有利影響占了 2.3 個百分點，另外 1.7%則是來自於產品組合的有利變化的貢獻。整體而言，我們預估毛利率會維持在 Q3 水平上下，隨著產品組合變化而波動。

接下來我說明盈利的狀況。在這一頁左上方淺綠色的是營業利益，第三季的營業利益為 3.8 億元，QoQ 成長 40%，主要是本季營收較前季增加的貢獻，這部分與去年同期相當。營業利益率為 25%，較前季增加 5%，YoY 則是減少了 5 個百分點。這主要是本季毛利率較去年同期低的影響。YoY 毛利下降的主要原因是高毛利的 VHM™ Wafer Sales 在本季沒有貢獻。

左下圖是營業利益 YoY 的逐季表現，本季較去年同期的高點持平。

在右手邊的圖是業外利益，這部分主要來自於外匯的兌換損益、利息收入以及金融資產評價的利益，本季為 4.8 億元。

本季由於營收以及毛利雙雙成長，以及業外利益的貢獻，第三季淨利來到了近 7 億元，單季淨利達到了歷史新高，較前季大幅成長 12 億，YoY 則是增加 106%。

接下來我就三個產品線在今年第三季的營運狀況分別為各位先進說明。

首先我們來看 IoTRAM™產品線。

IoTRAM™延續今年成長動能，本季營收 11 億元，與前季約略相同，年增為 22%。

接下來我針對 IoTRAM™的三個主要應用：Connectivity、Wearable 及 Video/ Audio/ Others 分別為各位說明本季的營收狀況：

首先是 Connectivity，在本季 IoTRAM™營收中占比 45%。QoQ 略減 3%，YoY 則是

增加了 37%。

穿戴裝置的部分，本季營收占 IoTRAM™ 31%，金額較前季增加 4%，YoY 成長 22%。

Video/ Audio/ Others 應用本季的營收較前季以及去年同期都有小幅的成長，在本季 IoTRAM™ 營收占比為 24%。

接下來我針對 IoTRAM™ 各個應用領域，來向各位進一步說明。

首先是 Wearable。穿戴裝置是一個蓬勃發展的市場，主要是由主流品牌客戶在主導。

產品的種類愈來愈多、對功能的要求也更加複雜多樣，再加上 AI 功能的導入，對產品的效能以及續航力的要求也愈來愈高，提升了對記憶體容量以及頻寬的需求，在整體市場銷量和搭載記憶體容量都同時有提升，IoTRAM™ 在這個應用領域還有很大的一個成長空間。

Connectivity 在今年出貨量較去年有明顯的回升，市場需求成長是一個因素，另一個因素則是本公司市占率也有所提升。Connectivity 這個市場，應用非常的廣，量體也非常的大，競爭也非常激烈，我們的 IoTRAM™ 是客戶最信任的記憶體解決方案，有越來越多的客戶切換到 IoTRAM™ 來。我們持續推出更好性價比的記憶體的解決方案來增加客戶產品的競爭力，以提升我們的市場競爭力。

在 Display 的部分，我們 IoTRAM™ 不管是在頻寬和功耗，相較於 DDR 更具優勢，有愈來愈多的客戶在新一代的產品採用了 IoTRAM™，新世代的規格也持續與客戶討論當中。

另外，ApSRAM™ 是我們今年推出新世代的 IoTRAM™。ApSRAM™ 提供了數倍於目前產品的頻寬、在功耗上也降低了數倍，滿足了客戶對效能以及低功耗的渴求，對 Display 以及穿戴裝置這類追求高效能以及長待機的應用，ApSRAM™ 是最佳的解決方案。目前已經獲

得了多個客戶的採用，已經進入了初期的量產出貨，在今年會上量。

接下來是 S-SiCap™ 產品線。

S-SiCap™ 產品線涵蓋了我們矽電容的各種形式的產品，包括了矽電容中介層 (Interposers with S-SiCap™)，也就是我們的 IPC，以及分離式的 S-SiCap™，我們叫做 IPD。

S-SiCap™ 產品線延續前季的成長，本季營收放量來到 3.1 億元，較前季成長 84%，YoY 則是成長了 6 倍，這主要是本季 IPC 多個專案量產產品出貨的挹注。

接下來，我用這三張圖來進一步說明我們 S-SiCap™ 在先進封裝的應用。

首先是矽中介層 (Silicon Interposer)，S-SiCap™ 在嵌入矽中介層應用中我們稱為 IPC。

這種 2.5D 封裝技術在業界通常稱為 “CoWoS-S”，適用於面積不大於四個光罩尺寸，也就是 Reticle Size 的晶片。由於 AI/HPC 發展迅速，在耗能以及運算不斷提升、速度不斷提升；在 2.5D 封裝中，對 SI/PI，也就是訊號以及電源完整性的要求也愈來愈嚴苛，因此要求矽中介層提供更大容量的電容來提升系統的穩定度以及整體的效能。愛普的 IPC 從去年第四季進入量產，在本季營收貢獻已達 21%。我們持續投入研發下一代的 IPC，將電容值再提升一倍，今年第四季將進入試產，隨著第二代的 IPC 量產，S-SiCap™ 將繼續快速成長，擴大我們的產品領先優勢。

當 2.5D 封裝需要更大面積的時候，molding-based interposer，如左中圖，也就是另外一種選項。這種封裝形式將 SoC 與其他如記憶體等元件，以重佈線的方式連接，再以 Molding 結合起來。這種 2.5D 封裝業界稱為 CoWoS-L。這類封裝需要整合更多、更高容值的分離式電容，我們的 IPC 目前就導入這個應用與客戶在規格討論當中，量產還需要一點

時間。

第三種是應用在嵌入封裝基板，就是 embedded in substrate 的應用，如左圖下。在 AI/HPC 中，都需要在封裝基板嵌入數十顆的 IPD，這個市場是非常大的。我們與數個大客戶在多家 Tier-1 基板廠進行製程開發以及驗證，已有初期的專案完成驗證，2026 年會有量產的營收貢獻。

隨著 AI/HPC 對算力的要求不斷提高，在先進封裝中，要求更高的多晶片整合度，封裝的面積也愈來愈大，就需要更多更高容值密度的電容，來確保電源以及訊號的完整性。隨著 HPC 以及 AI 的快速發展，我們的 S-SiCap™，不管是 IPD 還是 IPC，在這個領域會有非常大的成長空間。

接下來我們來看 VHM™產品線。

本季營收台幣 7 千 7 百萬元，主要是 NRE 的收入。較前季增加 16%，YoY 減少 76%，主要是因為去年同期有較多的 Wafer Sales 貢獻。去年的 Wafer Sales 主要是來自於加密貨幣的貢獻。那下一波的 Wafer Sales 將會是 AI 加速器的應用。

我們從 2018 年開始經營 VHM™，到目前可以大致分為三個階段。

第一個階段是 VHM™產品架構的早期概念驗證。這個階段主要是 VHM™架構效能驗證，以及 3D Memory 供應鏈生態的建立。第一個採用 VHM™架構的產品是以太礦機，用較成熟的製程，以一片 Logic 加一片 Memory 堆疊，達到的效能是先進製程 GPU 的數倍。在 2021 年第二季成功量產後迅速成為了以太礦機的主流架構，目前累計出貨已經達兩萬片。此時主流客戶也注意到了 VHM™的價值，我們開始與客戶討論 VHM™在 AI 以及 HPC 的應

用導入。

在第二階段是 VHM™量產以及主流應用的概念驗證。這個階段在持續經營礦機市場以外，我們的重點已經轉為 VHM™架構在 AI/HPC 應用驗證的專案執行。在這個階段，除了 1+1 的 VHM™架構外，我們也和客戶進行多層堆疊的設計開發，也就是我們的 VHMStack™。這些專案在去年有完成階段性的驗證，客戶也與我們進入了量產產品的討論階段。

今年 VHM™產品線進入了另外一個階段，重點在於主流應用的產品實現。我們與客戶合作的第一個針對 Edge AI 應用的多層堆疊架構的產品已經進入了執行的階段；另外，也有幾個產品與客戶在規格討論當中，其中包括了 Edge AI 以及 Server 端的應用，我們預計在今年還會有新的產品設計定案。

主流應用的產品它的開發週期會比較長，通常需要兩到三年，在這些專案開發驗證之後，VHM™將進入量產的第四個階段，我們相信屆時 VHM™業績將會有爆發性的成長。

另外，3DIC 行業環境也有明顯的改進。主流晶圓廠對於 3D Wafer-On-Wafer 的支持明顯提升，第一線和第二線的 DRAM 廠商也紛紛參與了 3D Memory 的業務，一起經營 3D 供應鏈生態系，客戶對 3D 架構的信心也大為提高，這些進展都是本公司希望看到的。

以上是三個產品線在第三季的 Update。

整體來看，在 IoTRAM™市場各個應用領域需求都有持續擴大以及 S-SiCap™對 IPC 業績大幅成長的帶動下，我們今年在出貨數量以及業績都有顯著地增長，對於明年延續這樣的成長趨勢，我們也樂觀看待。

另外，在 VHM™產品線，如剛才報告的，產品開發的時程需要較長的週期，但在量產後的營收成長性也比較大。我們第一個 VHMStack™產品專案已經進入了執行的階段，也有數個產品在設計導入階段，其中包括了 Edge AI 以及 Server 端、單層以及多層堆疊。有進展我們會在每一季的法說會向各位報告。

以上是我的報告，謝謝。

Q&A

謝謝總經理。本次的簡報到這裡告一個段落，接下來進入問答階段，請各位投資朋友於畫面右下角的欄位輸入您的問題，我們將於整理後統一回覆，謝謝。

問題：4Q sales outlook (4Q 銷貨展望)？ 哪些產品表現會高於平均？

回答：薛澤源 業務中心副總

我們看第四季的營收，有機會會超越第三季。目前 S-SiCap™還在營收的爬坡期，整體的成長比率會比較高。

問題：假設匯率相對穩定，GM outlook in 4Q25 (4Q25 的毛利率看法)？

回答：洪志勳 總經理

如果匯率沒有太大變動的話，我們看今年第四季的毛利應該會跟第三季接近。

問題：第三季毛利率看來回復至第一季水準，請問未來有機會回到去年 5 成的水準嗎？

回答：洪志勳 總經理

是的，毛利率五成也是我們經營的一個方向。

問題：Opex in 4Q25 (4Q25 營業費用的看法) ？

回答：林郁昕 財務長

營業費用的金額會隨著研發人力擴編、專案推進來持續地增加；那費用率的部分，會受到營收增減而有所影響，那預計 Q4 的費用率應該會與前幾季相當。

問題：請問公司研發費用不增反減，是否反映了研發專案進度上有瓶頸，減少投入？另請問公司目前研發人力是否足以支應這些新產品線的發展？

回答：陳文良 董事長

公司研發費用跟客戶專案的時程相關，逐季的變化並不一定反映整體的趨勢。就本季來看的話，研發費用的減少主要是專案 Milestone 認列相關的，也有一小部分是跟獎金相關的。

公司確實不斷地在增加研發人力。研發人力確實也是我們公司發展的瓶頸之一。但是我們有足夠的力量把目前這些產品推向市場。

問題：2026 年 IoT、AI BU、Interposer、Si-Cap 各自的重點發展方向是？

回答：洪志勳 總經理

我大概說明一下這三個產品線各自發展的重點：

在 IoTRAM™的部分，現在除了市場的持續經營以及拓展以外，我們明年的重點會在 ApSRAM™的量產以及應用面的擴大。

另外，在 VHM™的部分，這個產品線在這兩年的重點都是在於量產產品專案的執行，這包括了單層以及多層的專案部分。

對於 S-SiCap™產品線，持續拓展我們的 S-SiCap™ Interposer 的市場以外，持續經營嵌入基板的應用，與客戶以及供應鏈夥伴的合作是 S-SiCap™的經營重點。

問題：IoT in 2026，如果有成長，主要的成長會是哪些應用？是既有應用或者是否有新的應用？

回答：劉宗寧 產品中心副總

在 2026 年，IoTRAM™的成長會來自智慧穿戴、顯示裝置還有其他新的應用領域。

問題：IoTRAM™新一代 ApSRAM™在明年貢獻營收這個時程有任何改變嗎？明年大約開始
營收貢獻的時間點會落在幾月？

回答：劉宗寧 產品中心副總

ApSRAM™目前已經開始初期的量產出貨了。

問題：Interposer 2025 看到顯著的成長，公司可否分享主要的成長動能在哪裡？是否有
2026 能見度？能否快速成長？

回答：劉宗寧 產品中心副總

高速運算晶片對於 Interposer 的需求是持續增加，而愛普的產品是目前世界上唯二高效且可穩定量產的矽電容中介層解決方案。我們相信 2026 年營收會持續成長。

問題：能否分享國際客戶使用或接觸愛普 interposer 的進度？

回答：洪志勳 總經理

我們的 interposer 主要都是國外的 AI 以及 HPC 的客戶，那現在的 OSAT 在 2.5D 封裝的技術已經非常成熟了，那我們的模式是客戶向我們採購 interposer，然後在 OSAT 這邊生產。那目前已經有幾個專案在量產當中，我們每個月大概有一兩千片的出貨。

問題：越來越多公司在討論 3D 堆疊的技術及應用，請問愛普相較於其他記憶體競爭同業的
優勢為何？

回答：陳文良 董事長

愛普在 3D 堆疊的優勢主要是我們的技術比較成熟，我們對客戶的應用有比較多的經驗。3D 堆疊的 DRAM 的生產和品質管理可以說完全顛覆了傳統 DRAM 的思路。在這樣一個新的生產品質管理的框架下面，客戶是依賴愛普來保障產品的生產良率和品質可靠性的。這是一個非常高黏著度的關係。

問題：VHM™目前主要量產的案子是礦機，這兩季都沒有出貨，請問 2026 礦機的成長性為何？更重要的是，請問在其他的應用上何時會有顯著營收貢獻？

回答：劉宗寧 產品中心副總

由於虛擬貨幣市場變化非常快速而且不易預測，我們會持續和客戶開發有競爭力的方案來把握任何的市場商機。而 AI 加速器是 VHM™產品線主要發展的方向，目前在做的這些 AI 加速器產品有望在 2027、2028 年開始貢獻營收。

問題：VHM™在穿戴式產品的應用預期何時量產？應用高效能運算產品預計何時量產？

回答：洪志勳 總經理

剛才簡報中有大概提到 VHM™產品開發的週期比較長，一般需要 2 到 3 年的時間；穿戴式產品我們預計在 2027 年的年底能夠進入量產準備，HPC 的應用如果我們後續順利定案的話，量產時間會落在 2028 年。

問題：目前與第二家代工廠合作的進度為何？如果有第二家代工廠，會是哪些 end applications？

回答：洪志勳 總經理

我們目前的確有一些進展，只是說這些都還在進行的當中，現在不太方便透漏。我們合作的模式大概都是我們和客戶一起與代工廠談合作，那這些案子主要都是 HPC 跟 AI 的應用。

問題：公司會考慮授權給其他 memory 公司或客戶使用愛普的專利嗎？

回答：陳文良 董事長

愛普的業務是以客戶為中心。如果客戶有這樣的需求，我們當然會考慮。

問題：請問 WoW 在 Edge AI 的應用狀況？VHM™我們拿到的第一個針對邊緣運算 Edge AI 應用的產品設計案目前順利進行中嗎？時序有無延遲或比預期更快？若順利，預計何時能量產貢獻營收？這個項目的合作代工廠是否已經敲定好？屆時能否有足夠的產

能因應這一塊業務項目？

回答：陳文良 董事長

這裡問到不少細節，上一季法說會我們有提到有 Edge AI 的應用已經開案，這個專案正在進行中。合作的代工廠有敲定，時程也沒有落後，也有足夠的產能。

那從整個行業的角度，Wafer-on-Wafer 在 Edge AI 的應用其實剛剛開始，逐漸會有更多的客戶在這方面開案。

問題：最近記憶體市場開始復甦，記憶體報價往上走揚，愛普相關記憶體報價是否也會走揚？

未來記憶體部分營收獲利是否增加？

回答：薛澤源 業務中心副總

愛普經營的是客製化的產品，我們要提供給我們長期的合作夥伴是一個長期比較穩定的訂價，短期的這些價格波動在標準型產品這邊，跟我們比較沒有關係。

問題：三個產品線中，IoT 穩定、S-SiCap™ 成長快速、VHM™ 相對 slow，請問 26 年也是

類似的產品線營收占比？也是 IoT > Si-Cap > VHM™ 嗎？中長期怎麼看？

回答：薛澤源 業務中心副總

明年三個產品線的營收都有機會持續成長，尤其是 S-SiCap™ 這個部分目前還在營收的爬升期，營收的占比還會再提升。但整體的營收來看，明年最大的仍然是 IoTRAM™，那其次就是 S-SiCap™。那從這個目標市場的長期潛力來看，我們認為 VHM™ 跟 S-SiCap™ 的營收未來將會超越 IoTRAM™。

問題：可否說明一下愛普在 IPC、IPD 的 Business Model？如何計價？一樣是跟 PSMC 合

作嗎？或者有其他合作對象？

回答：劉宗寧 產品中心副總

目前 S-Sicap™ 產品線，它主要的營收是來自銷售 IPC 的晶圓還有 IPD 的電容顆粒。力積電是我們目前 Si-Cap 產品的晶圓代工廠。未來也有可能會有其他合作的對象。

問題：目前記憶體市況火熱，供不應求，愛普目前庫存狀況是否足以支應出貨需求？會有產能不足的情形嗎？

回答：洪志勳 總經理

愛普主要經營的是客製化的產品，那我們經營的重點是確保客戶的需求能夠被滿足以及品質。那所以不管是與客戶在需求端的溝通或是整體產能的運用的動態佈建，都是我們營運的重點，我想這個部分不會是問題。

問題：S-SiCap™有提到三種不同的 solution，面對的是相同的客戶嗎？也都是 AI 的應用嗎？請問怎麼看這三種 solution 未來的發展或是占比？

回答：陳文良 董事長

確實，應用都是 AI 或者是其他的 HPC，但是客戶不盡相同，原因是各個客戶在 AI 市場定位不太一樣，所以產品方案也不太一樣。

那短期來看，營收來源主要是 IPC，就是用於 CoWoS-S 這類 2.5D 封裝的 IPC。

但是長遠來看，市場最大的會是 IPD，但是這個還需要一段時間。

問題：有提到 IPD 嵌入基板的應用正與多家 Tier-1 基板廠合作開發，之前跑驗證，又過了一季，預計有機會在 2026 年量產的時程依然如舊嗎？

回答：劉宗寧 產品中心副總

是的，目前預計在 2026 年進入量產。

問題：請問對於 2026 年度記憶體產業的看法如何？貴公司在記憶體產業這波榮景中搶占到什麼成長機會？

回答：薛澤源 業務中心副總

愛普在這個 DRAM 領域，我們還是會持續聚焦於客製化的 IoT 記憶體。那從目前的觀察來看，2026 年的整體需求良好。愛普在長期耕耘的市場份額可望可以進一步的提升。我們今年 2025 年一整年投入在新客戶、新市場應用、新的專案的設計導入也都會在今年底、

明年初陸續放量生產，所以出貨量的上升將會帶動業績的持續成長。

問題：請問公司 interposer 業務先前都是中國客戶，近期有聽到取得美系大客戶訂單，可否針對 2025 年前三季，還有 4Q25 到 2026 年此部分的展望？分中國與美系客戶來做說明，另外此部分的獲利狀況該如何看待？

回答：陳文良 董事長

Interposer 我們的客戶當中，確實中國的跟歐美的都有，但是在這個階段客戶還相當集中，所以我們目前不方便提供更多的訊息。在獲利方面，長遠來看，我們這個產品線的毛利率會跟整體公司的毛利率相當。

問題：想請問公司在 IPD 方面的產品優勢為何？

回答：劉宗寧 產品中心副總

我們 IPD 產品的優勢來自於我們和客戶、封裝基板廠商長期以來持續在產品開發，以及品質驗證所獲得的經驗以及成果。

問題：VHM™的 AI 加速器 Wafer Sales 預估何時會開始貢獻？對比 2024 年虛擬貨幣的貢獻，是否有機會超過？

回答：劉宗寧 產品中心副總

像剛剛提過的，我們在 AI 加速器這裡預計在 2027 年、2028 年會有貢獻，那因為 AI 的市場潛力無窮，我們相信未來它的貢獻一定會大於虛擬貨幣。

問題：請問目前 Si-Cap 的產能？預期 2026 年底的產能？此外，IPC 擁有中介層設計是否毛利高於 IPD？

回答：洪志勳 總經理

因為我們的 Si-Cap 的製程架構是用 Stacking 的方式，類似於記憶體製程，所以這部分的產能基本上不是問題，我們有數萬片的產能。那預期在 2026 年以及滿足未來的需求，我想這個都不會是有問題，不需要新佈建、新的製程。此外，在 IPC 這邊中介層，IPC 與 IPD

的毛利，其實 IPD 的毛利會略高於 IPC，因為 IPD 有較多的客製化的含量在裡面，但是整體來說，像剛才董事長說的，就是我們這個毛利會大概落在我們公司的目標的毛利率區間之內。

問題：請問各產品線在未來有漲價的規劃嗎？

回答：薛澤源 業務中心副總

如前所述，我們經營的都是客製化的產品。那愛普我們要做的其實就是提供我們長期經營的客戶，一個良好的品質以及長期穩定的價格。

問題：請問 VHMStack™ 的量產時程預計是 2027 年嗎？

回答：洪志勳 總經理

我剛才在報告裡面有提到，我們第一個 VHMStack™ 的產品預計在 2027 年可以完成量產的準備，那大概的時間點會落在 2027 年年底到 2028 年之間。

問題：請問第二代 IPC 量產後，第一代的 IPC 就 phase out 嗎？

回答：劉宗寧 产品中心副總

由於不同的客戶產品應用會有不同的規格需求，所以我們沒有 phase out 第一代的打算，會把它推薦給適合的產品跟客戶。

問題：CoWoS-L、RDL 與內埋式載板、矽電容、垂直供電架構等的應用是否可以期待為公司帶來巨大的營收成長？

回答：洪志勳 總經理

我想答案是是的，因為在 CoWoS-L 這樣的一個架構，就是從業界，就是客戶是一直往這邊去推，因為現在整個系統來說，它要整合的 SoC 越來越多，還有整個基板的面積也要求越來越大，CoWoS-L 是一個必定的趨勢，那在這一個趨勢之下，其實對於電容的數量的要求以及 IVR 這部分其實都有很大的機會，這是一個非常大的市場，我也同意您的看法。

問題：日前有公告增資子公司 APware，請問這個子公司主要的業務/產品是？另外，VHM™ 的 Edge AI 進入執行階段，請問是表示有機會在 1 年後量產？請問 ApSRAM™ 的價格是否比既有 IoTRAM™ 產品有所提高？請問可否分享 IPC interposer 對於 foundry 廠明年底的產能規劃？

回答：陳文良 董事長

第一個 APware。APware 是我們主要用來投資對外的新創公司的一個子公司。我們有公告過一些對外的新創公司的投資，都是從 APware 來做的。

第二段講到 VHM™ 的 Edge AI。確實，我們已經進入執行階段了，但是這個不代表說一年後就能量產，這個量產的時程可能會更長一些。這個可能更具體的我們也不方便分享。

第三段講到 ApSRAM™。確實，ApSRAM™ 的價值是高於 IoTRAM™ 的，但售價這有時候就是一個業務定價的問題，這個可能有時候也說不定。

第四段講到 IPC Interposer 的產能規劃。目前 Foundry 是針對我們客戶的產能需求來做規劃的，目前的規劃是有跟上客戶的產能需求的。

問題：請問 IoTRAM™ Connectivity 這邊明年的展望好嗎？會不會拖累 Wearable？

回答：薛澤源 業務中心副總

我們在 Connectivity 這一個應用，無論是市場的份額或出貨量，仍然在持續上升當中。那當然，由於激烈的終端市場的這些競爭，Connectivity 的成長趨勢沒有其他應用或其他產品線這麼明顯，但對我們來講 Connectivity 仍然是一個非常重要而且需要長期深度耕耘的應用。

問題：目前 VHM™ 主要代工廠記憶體製程相較同業非前段，未來在 VHMStack™ 相關產品有機會與其他記憶體代工廠合作嗎？

回答：陳文良 董事長

簡單的說是有。那具體的這個過程，就是客戶會看到一些需求，我們目前的供應商，或者我們正在討論的供應商，不見得能夠百分之百的滿足，所以我們就會跟客戶一起引入一些

新的 Foundry Partner。

問題：VHM™研發時程很長，客戶如果又多的話，公司研發量能足夠嗎？公司研發支出又在減少，研發時程長是不是研發量能不足？

回答：陳文良 董事長

好像剛才有一個類似的問題，我們研發支出少是因為別的原因，不是我們人力不夠或是怎麼樣。那目前我們的研發人力的配置當然也跟我們整體業務的需求相關，我們目前是跟得上的。

感謝各位投資先進的提問，問答階段在此告一個段落，會後若有其他問題，各位可聯繫本公司 IR 團隊。

感謝各位的參與，今天的會議到此結束，謝謝！

聲明

若逐字稿內容與法說會現場陳述內容有不一致之處，應以法說會現場陳述內容為準。

上述訊息所提供對於產業及本公司前景之預測，係根據目前營運及公開資訊所做出之判斷，相關內容具風險與不確定性，任何外在環境的改變均可能影響公司實際營運與財務狀況。

上述訊息中所提供之資訊，不代表本公司對產業狀況或後續重大發展的完整論述，本公司亦不會因任何新的資訊或事件而更新相關資訊。